

第89期 報告書

2023年4月1日から2024年3月31日まで



新光電気工業株式会社

証券コード6967



株主の皆様には、平素よりひとかたならぬご支援を賜り厚く御礼申しあげます。第89期報告書をお届けするにあたり、一言ご挨拶申しあげます。

代表取締役社長

倉嶋 進



超高速大容量通信を実現する情報通信基盤の進化やAI、IoTの急速な利用拡大等を背景とするDX（Digital Transformation）の進展が、経済や社会の仕組みに大きな変化をもたらし、これまでとは次元の異なるイノベーションを生み出す可能性を秘めており、半導体は、その可能性を実現するキーテクノロジーとして革新を続けていくことが期待されております。また、自動運転等の技術開発が加速する自動車市場や多様な分野での活用が期待されるロボティクスなど、半導体は、今後も市場を拡大することが見込まれています。加えて、GX（Green Transformation）の実現に不可欠なテクノロジーの進化を支えるキーデバイスとして、半導体のニーズはさらに高度化・多様化することが想定されます。

当社グループは、半導体デバイスの優れた機能を人々の生活のなかへともたらすインターコネクトテクノロジーをベースに、高い競争力を持つ製品の開発に努め、お客様にとって価値の高い製品・サービスをご提供することにより、お客様の成功を支え、自らの発展・成

長を目指してまいります。

また、当社グループの企業理念・指針である「SHINKO Way」の実践を通じ、ステークホルダーの方々との調和をはかるとともに、気候変動をはじめ、多様なサステナビリティ課題に対する取り組みを推進してまいります。

なお、今後、当社株式については、JICキャピタル株式会社を中心に構成される公開買付者による公開買付けの実施が予定されております。当社は、市況環境変化の激しい半導体産業にあって、本公開買付けおよびその後の一連の取引の実行を通じて当社株式の非公開化をはかり、次世代半導体ビジネスの推進や次世代製品における市場競争力の強化等に取り組み、中長期的かつ持続的な企業価値向上を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2024年6月

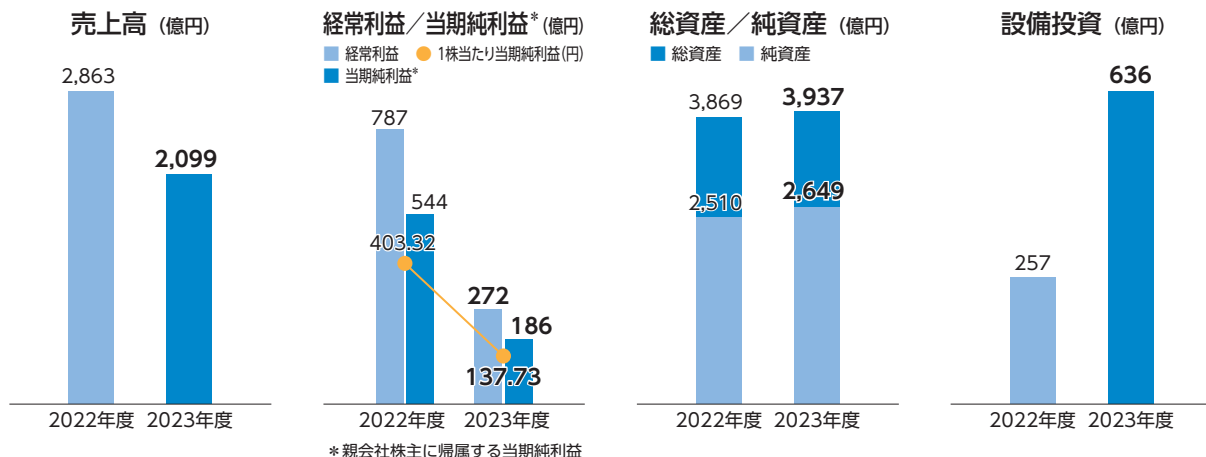
2023年度の事業概況

当期の半導体業界は、AI向け半導体の需要拡大に伴う市場環境の改善が一部に見られるものの、パソコン、サーバー市場の低迷継続や、買い替えサイクル長期化等によるスマートフォン需要の減少、米国による対中半導体輸出規制ならびに在庫調整の影響などにより、市況低迷が長期化する厳しい環境が続きました。

このような環境の下、当社グループでは、パソコン、スマートフォン需要低迷や在庫調整の長期化等を背景とする半導体市況回復の遅れの影響を大きく受けるなか、収益確保をはかるべく受注獲得および生産性向上、コストダウン等に注力しました。また、これまで継続的に取り組んでまいりました成長市場向けの設備投資については、市況環境をふまえ、計画の一部見直しを行いました。半導体市場の中長期的な拡大や当社製品の今後の需要増加を見据え、引き続き重点的に経営資源を投下しました。半導体の一層の高機能化・高速化や省電力化等のニーズに対応するフリップチップタイプパッケージについては、新たな生産拠点として千曲工場（長野県千曲市）

の工場建屋が竣工するなど、生産体制強化に向けた取り組みを推進しました。また、先端半導体向け次世代フリップチップタイプパッケージに関する千曲工場における新たな設備投資計画が、「経済安全保障推進法」に基づく「供給確保計画」に認定され、助成金の交付が決定されました。プラスチックBGA基板については、生産能力増強をはかるべく、新井工場（新潟県妙高市）において新棟建設に着手しました。

これらの結果、フリップチップタイプパッケージは、パソコン・サーバー需要の回復の遅れ等により売上が大きく減少しました。また、セラミック静電チャックは半導体輸出規制に加え、市況悪化の影響を受け売上が大きく減少するなど、総じて市況低迷の影響を受けました。これらにより、売上高は2,099億72百万円（前期比26.7%減）となりました。利益面につきましては、売上高減少の影響を大きく受け、経常利益は272億57百万円（前期比65.4%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は186億9百万円（同65.8%減）となりました。



■ 今後の見通し

今後の半導体業界は、AIを活用したサービスの急速な拡大等を背景に、メモリーをはじめとして半導体需要の回復が期待されるものの、パソコン、サーバーおよびスマートフォン市場の回復の遅れや半導体の在庫調整がさらに長期化する懸念が払拭できない状況が継続することも想定されます。一方、DXの進展等による社会・経済のデジタル化や、持続可能な成長の実現を目指す脱炭素社会への移行と情報通信量の大幅な増加による電力消費の抑制を両立するGXの実現を支えるキーテクノロジーとして、半導体の重要性が高まるとともに、高度化・多様化する市場のニーズや需要動向の変化に対し、迅速かつ柔軟に対応し得る開発・生産体制を構築することを要するなど、世界規模での競争が一段と激化することが見込まれます。また、半導体のさらなる高機能化・多機能化のニーズへの対応をはかるうえで、半導体製造におけるパッケージングプロセスの重要性が高まっており、特に、当社が主な事業内容とする半導体パッケージは、半導体の一層の高機能化・高速化と省電力対応に欠くことのできない中核製品として半導体産業におけるニーズがさらに高まることが想定されます。

このような環境の下、当社グループは、営業体制の一層の強化に努め、市場環境の変化を的確に把握し、積極的な受注活動を展開することなどにより売上確保をはかるとともに、全社において生産性向上・効率化、徹底したコストダウン等の取り組みを強化してまいります。また、これまで高い成長が見込まれる市場向けに継続的・

重点的に経営資源の投下をはかってまいりましたが、市場環境をふまえ、必要により時期・内容を適切に判断のうえ、引き続き当社製品の中長期的な市場拡大を見据えた設備投資を展開してまいります。フリップチップタイプパッケージについて、昨年12月に竣工した千曲工場（長野県千曲市）における量産体制整備等をはかるとともに、半導体メモリーの高速化・大容量化に対応するプラスチックBGA基板については、新井工場（新潟県妙高市）において着工した新棟建設を着実に実行してまいります。加えて、中長期的に大きな成長が見込まれるHPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）市場のニーズに対応する当社開発の「i-THOP[®]」をはじめとする先端半導体向け次世代フリップチップタイプパッケージの千曲工場における新たな設備投資計画を推進してまいります。また、次世代情報通信基盤の構築における基幹デバイスとして、消費電力の飛躍的な低減とデータ処理の超高速化を実現する「光電融合デバイス」の開発に注力するなど、これまで培ってまいりました最先端の半導体実装技術をもとに、市場ニーズを先取りした新商品・新技術の確立・量産化に取り組み、持続的な成長・発展を目指してまいります。

当社グループは、引き続き成長が見込まれる半導体市場にあって、常にお客様のニーズを起点とし、機能・性能、コスト、品質すべてにおいてお客様にとって価値の高い製品・サービスを提供することにより、「限りなき発展」を果たしてまいります。

決算概要（連結）

Financial Statements(Consolidated)

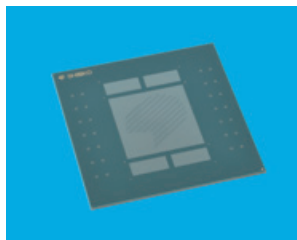
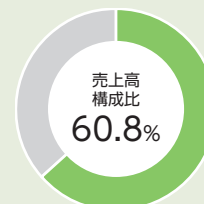
■ 連結貸借対照表			2024年3月31日現在		
(単位：百万円)			(単位：百万円)		
科 目	当 期	前 期	科 目	当 期	前 期
資 産 の 部	393,750	386,934	負 債 の 部	128,773	135,919
流 動 資 産	184,459	226,075	流 動 負 債	126,946	133,545
固 定 資 産	209,291	160,858	固 定 負 債	1,826	2,374
有 形 固 定 資 産	201,984	154,068	純 資 産 の 部	264,977	251,014
無 形 固 定 資 産	1,175	876	株 主 資 本	264,119	252,205
投資その他の資産	6,131	5,912	資 本 金	24,223	24,223
資産合計	393,750	386,934	資 本 剰 余 金	24,222	24,173
			利 益 剰 余 金	215,736	203,882
			自 己 株 式	△ 61	△ 74
			その他の包括利益累計額	857	△ 1,190
			負債純資産合計	393,750	386,934

■ 連結損益計算書			2023年4月1日～2024年3月31日		
(単位：百万円)			(単位：百万円)		
科 目	当 期	前 期	科 目	当 期	前 期
売 上 高	209,972	286,358	営業活動によるキャッシュ・フロー	45,464	118,223
売 上 原 価	171,070	194,664	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,273	△ 65,199
売 上 総 利 益	38,902	91,693	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,886	△ 7,197
販売費及び一般管理費	14,091	14,980	現金及び現金同等物に係る換算差額	1,578	1,006
営 業 利 益	24,810	76,712	現金及び現金同等物の増減額	△ 33,116	46,833
営 業 外 収 益	2,530	2,142	現金及び現金同等物の期首残高	115,592	68,758
営 業 外 費 用	83	99	現金及び現金同等物の期末残高	82,475	115,592
経 常 利 益	27,257	78,755			
特 別 利 益	784	—			
特 別 損 失	2,126	1,295			
税金等調整前当期純利益	25,915	77,460			
法人税、住民税及び事業税	6,750	23,041			
法 人 税 等 調 整 額	555	△ 69			
親会社株主に帰属する当期純利益	18,609	54,488			

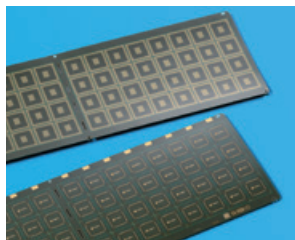
セグメント別の状況

プラスチックパッケージ

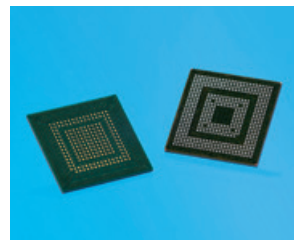
売上高	1,277億52百万円	前期比27.8%減	↓
経常利益	118億28百万円	前期比75.0%減	↓



フリップチップタイプパッケージ



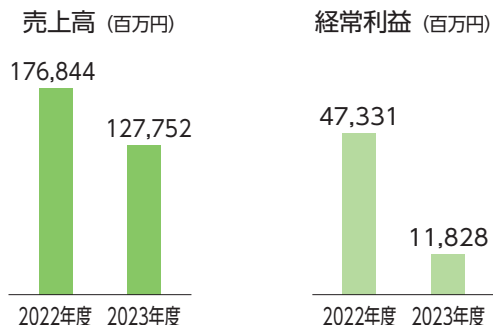
プラスチックBGA基板



IC組立

フリップチップタイプパッケージは、コロナ特需の反動などによるパソコン・サーバー需要回復の遅れや競争激化などにより、大幅な減収となりました。プラスチックBGA基板は先端メモリー向けが在庫調整の影響を受け、IC組立はスマートフォン市場の減速によりハイエンドスマートフォン向けの需要が減少するなど、それぞれ売上が減少しました。

これらの結果、当セグメントの売上高は1,277億52百万円（前期比27.8%減）、経常利益は売上高減少の影響を大きく受け118億28百万円（同75.0%減）となりました。

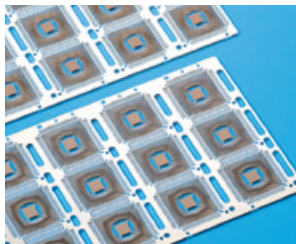
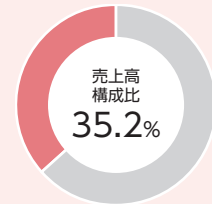


【主な搭載製品例】

パソコン、サーバー、スマートフォン、
自動車、民生機器 他

メタルパッケージ

売上高	738億78百万円	前期比25.6%減	↓
経常利益	161億33百万円	前期比48.3%減	↓



プレスリードフレーム



セラミック静電チャック



ガラス端子

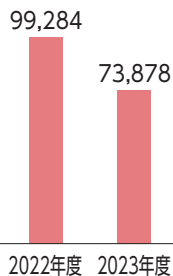


ヒートスプレッダー

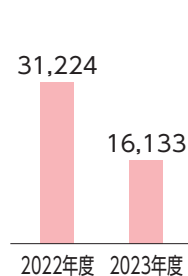
半導体製造装置向けセラミック静電チャックは、米国による対半導体輸出規制やメモリー市況悪化などの影響を受け、大幅な減収となりました。リードフレームは、半導体市況低迷による在庫調整等を背景に受注が減少し、また、CPU向けヒートスプレッダーは、パソコン・サーバー需要減退等の影響を大きく受け、ガラス端子は光学機器向けが低調に推移し、それぞれ売上が減少しました。

これらの結果、当セグメントの売上高は738億78百万円（前期比25.6%減）、経常利益は売上高減少の影響を大きく受け161億33百万円（同48.3%減）となりました。

売上高 (百万円)



経常利益 (百万円)



【主な搭載製品例】

自動車、スマートフォン、パソコン、
民生機器、半導体製造装置、通信機器 他

※セグメント別の売上高は外部顧客への売上高であり、経常利益はセグメント間取引調整前のものです。

JICC-04株式会社による 当社株式に対する公開買付けの開始予定につきまして

当社は、2023年12月12日開催の取締役会において、JICC-04株式会社（以下「公開買付者」）による当社の普通株式（以下「当社株式」）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」）に関して、同日時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。

なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付けおよびその後に予定された一連の手続により、当社株式の全てを取得することを企図していること、および当社株式が上場廃止となる予定であることを前提としております。

本公開買付けの概要

1) 買付け等の期間

本公開買付けは、国内外の競争法ならびに国外の投資規制法令等に基づく必要な手続および対応に一定期間を要することが想定されているため、本公開買付けの開始時期については、公開買付者により、2024年8月下旬が目指されてはいるものの、国外の競争当局および投資規制法令等を所管する当局における手続等に要する期間に影響されます。また、公開買付期間は20営業日となる予定です。

2) 買付け等の価格：普通株式1株につき、5,920円

3) 買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
67,530,488株	22,491,400株	一株

配当（無配）につきまして

当社は、株主の皆様への利益還元を充実させていくことを経営の最重要施策の一つとして位置付けてまいりましたが、公開買付者によれば、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2024年3月31日を基準日とした配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されていることから、2023年12月12日開催の取締役会において、2024年3月期の配当予想を修正し、2024年3月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。

株主優待制度の廃止につきまして

当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多くの株主の皆様の中長期的に当社株式を保有していただくことを目的として、毎年3月31日を基準日として株主優待制度を実施してまいりましたが、当社株式に本公開買付けが行われる予定であることをふまえ、2023年12月12日開催の取締役会において、当該株主優待制度を廃止することを決議いたしました。

本公開買付けに関するQ&A

Q なぜ本公開買付けが行われるのでしょうか？

A 当社として企業価値の向上に向けた様々な経営戦略の検討を進めるなか、富士通株式会社より保有する当社株式を売却したい旨の意向を受け、同社との協議を開始しました。その後、上場維持を含む様々な選択肢を慎重に検討した結果、当社が「限りなき発展」を目指すためのパートナーとして、成長市場向けの設備投資・技術開発を重点的に展開する当社の事業方針を基本的に支持し、政府系ファンドとして短期的な業績変動に動じず、中長期的な観点で企業価値の向上に資する取組みを推進していくことが可能なJICキャピタル株式会社を中心に構成される公開買付者をパートナーとして非公開化を目的とした本公開買付け等を実行し、これまで以上の意思決定のスピードアップをはかり、当社事業推進において根幹となる人的資本の拡充などの施策を進めることが今後の企業価値の向上に資するとの結論に至りました。

Q 公開買付けはいつ開始されるのでしょうか？

A 公開買付者は、2024年8月下旬を目途に本公開買付けを開始することを目指しているとのことですが、国外の競争当局および投資規制法令等を所管する当局における手続等に要する期間を正確に予想することは困難であるため、本公開買付けのスケジュールの詳細は、決定次第速やかにお知らせするとのこととです。

Q 上場廃止となる時期を教えてください。いつまで市場で売却できるのでしょうか？

A 現時点では未定です。本公開買付けが成立した場合、当社株式は非公開化されることが予定されており、所定の手続を経て当社株式は上場廃止となります。なお、上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所プライム市場において取引することはできません。

Q 応募手続の詳細について教えてください。

A 公開買付者によれば、具体的な応募手続は、決定次第速やかにお知らせする予定とのこととです。

Q 公開買付けへの応募手続はいつからできますか？

A 本公開買付け開始後に応募手続を行うことができます。なお、2023年12月12日開催の取締役会において、同日時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしており、本公開買付けが開始される時点で、改めて意見表明を行うことを併せて決議しております。

本公開買付けに関する詳細は当社ウェブサイト掲載の「JIC-C-04株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」をご覧ください。

会社の概要

Corporate Data

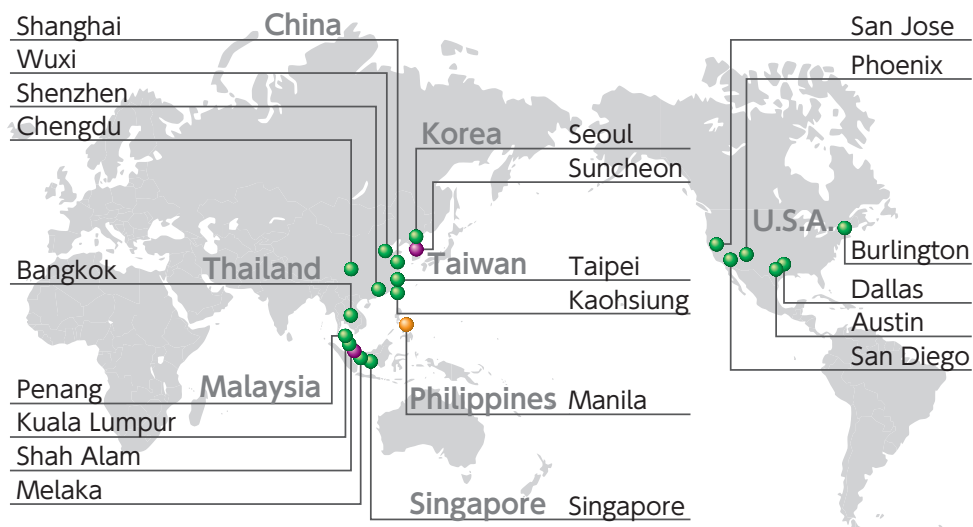
(2024年3月31日現在)

取締役

(2024年6月26日現在)

- 商号 新光電気工業株式会社
- 設立年月日 1946年9月12日
- 本社 長野県長野市小島田町80番地
電話 (026) 283-1000〔代表〕
- 主な事業内容 プラスチック・ラミネート・パッケージ、
リードフレーム、ガラス端子、ヒートスプレッダー、
セラミック静電チャックなどの製造・販売、
ICアSEMBリ
- 従業員数 4,808名 (連結5,553名)
- 工場等 更北、若穂、千曲、高丘、新井、京ヶ瀬、
新光開発センター、栗田総合センター
- 営業所等 東京、大阪、名古屋、福岡、マニラ
- グローバルネットワーク

代表取締役会長	藤田正美
代表取締役社長	倉嶋進
取締役専務執行役員	伊藤明彦
取締役常務執行役員	小澤隆史
社外取締役	新美潤
取締役常勤監査等委員	平林利康
社外取締役監査等委員	荒木泉水
社外取締役監査等委員	小林邦一



株式の状況

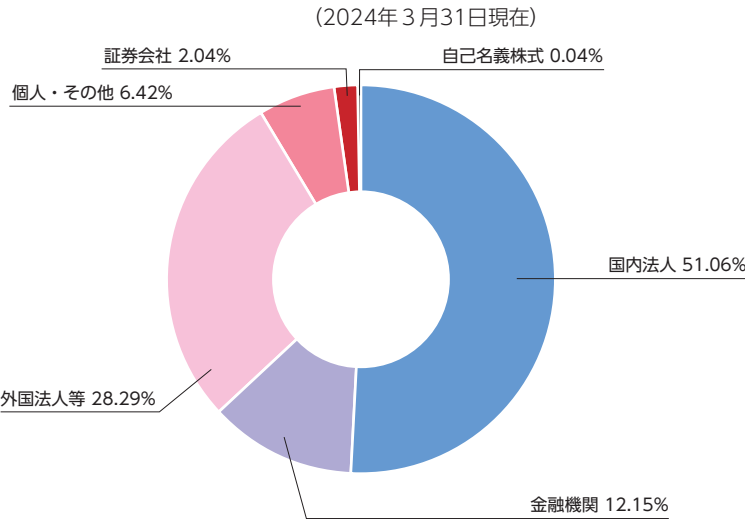
Shareholders' Data

発行可能株式総数	540,000,000株	資本金	24,223,020,480円
発行済株式の総数	135,171,942株	株主数	15,538名
大株主			

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
富士通株式会社	67,587	50.02
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	8,857	6.56
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	3,613	2.67
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	3,257	2.41
JPLLC-CL JPY	2,304	1.71
JP JPMSE LUX RE CITIGROUP GLOBAL MARKETS L EQ CO	2,203	1.63
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT	2,170	1.61
JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO	1,927	1.43
株式会社八十二銀行	1,836	1.36
JPLLC CLIENT ASSETS-SK J	1,806	1.34

(注) 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

所有者別株式分布状況



株式事務のご案内

■株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関

(連 絡 先) 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町 1-1
電話 0120-232-711 (通話料無料)

(郵 送 先) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

■事業年度

4月1日から翌年3月31日まで

■基準日

定時株主総会関係
配当金受領株主確定日 3月31日
3月31日および中間配当金の支払いを行うときは9月30日

■公告方法

電子公告
当社は、公告を下記ウェブサイトに掲載しております。
<https://www.shinko.co.jp/ir/kk/>
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

(ご注意)

1. 株主様の住所変更、買取請求その他の各種お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。
2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記の連絡先にお問い合わせください。三菱ＵＦＪ信託銀行全国各支店においてもお取り扱いいたします。
3. 未受領の配当金（除斥期間が経過したものを除く。）につきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行本支店でお支払いいたします。
4. 株主総会資料の電子提供制度に関するお問い合わせ先
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部
電子提供制度専用ダイヤル 0120-696-505



新光電気工業株式会社

〒381-2287 長野県長野市小島田町 80 番地
電話(026)283-1000〔代表〕FAX(026)284-8861
<https://www.shinko.co.jp>



JPX日経インデックス400 構成銘柄



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。



地球環境に配慮した
植物油インキを
使用しています。